

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司
2026 年 10 月 15 日投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	景林资产、光大证券研究所、麦格理集团、招商证券自营、中安汇富、广金投资、中信证券、长城证券、恒泽私募证券、赞道私募证券
时间	2026 年 10 月 15 日
地点	公司本部会议室
上市公司 接待人员姓名	董事长 周庚申 董事会秘书 钟彦
投资者关系活 动主要内容介 绍	本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势以及产品与业务，并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。 一、公司基本情况介绍 公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在 MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service, EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流支持、销售服务以及自主品牌产品产销研等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端三大主营业务的发展战略格局。

	二、交流环节 1. 沛顿科技在深圳和合肥的产能准备情况？ 答：公司目前合肥封测处于满产状态，并根据客户近期需求在扩产。公司一直密切关注客户动态，并始终基于对行业趋势与市场需求的动态研判，进行有利于公司长远发展的产能布局。 2. 16层堆叠的NAND Flash的良率如何？ 答：作为国内领先的高端内存芯片封装测试企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力，公司核心产品良率表现良好，未来，公司将持续密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势。 3. 公司在存储封测方面的进展，客户产品品类、份额是否有提升？产能建设进度，未来潜在空间？ 答：公司目前订单情况正常，合肥封测处于满产状态，并根据客户近期需求在扩产，公司一直密切关注客户动态，并始终基于对行业趋势与市场需求的动态研判，进行有利于公司长远发展的产能布局。 4. 消费电子业务表现如何，储存涨价影响程度？ 答：公司消费电子业务开展正常。封测价格受市场供需、客户协议等多重因素影响，公司根据市场动态和客户合作模式进行合理定价。 5. 公司扩产完成后产能能达到多少？ 答：项目计划总投资18.5亿元，一是拟投资12.2亿元新设全资子公司建设新厂房，经测算可承载传统封测9万片/月及2.5D先进封装1万片/月产能；二是拟投资6.3亿元建设2.5D/3DS先进封装研发线，建成达产后预计增加2.5D/3DS先进封装产能各100片/月。 6. 当前业务的主要卡点是什么？ 答：公司可能面对的风险包括宏观经济波动风险、汇率风险、供应链重构风险和人才竞争风险，公司具备完善的风险防范机制。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等
--	--

	情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 10 月 15 日